**2025年度晶上产业技术能力入库申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | |
| **单位性质** |  | **所在地区** | |  | |
| **十五五晶上规划参与意愿** | **□ 晶上纵向项目合作——联合策划和承担国家纵向任务**  **是否具备经费配套能力？ □ 是 □ 否**  **□ 晶上中试服务合作——晶上产业创新平台（开展技术攻关、成果转化、应用示范、标准认证）**  **□ 晶上熟化量产合作——产业化落地项目** | | | | |
| **所属晶上产业链环节** | **□ 设计环节**  □ 架构设计 □ EDA工具 □ 预制件设计  □ 晶圆基板设计 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ 制造环节**  □ 材料 □ 设备 □ 预制件制造 □ 晶圆基板制造  □ 集成 □ 供电 □ 散热 □ 辅助PCB  □ 系统组装 其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ 测试**  □ 芯粒测试 □ 晶圆基板测试  **□ 应用环节**  □ 应用软件开发 □ 应用部署  其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **晶上产业图谱编委征集（选填）** | **该部分内容晶上联盟专委会专家或专委会同级别专家请着重填写。**  **专家姓名：**  **单位及职务：**  **对晶上技术发展的寄语（200字以内）：** | | | | |
| **当前能力水平** | 介绍单位掌握哪些晶上系统相关技术（可列举多项），能够支撑晶上系统落地智能网联车、工业机器人、AI信创（如算力中心、领域专用AI一体机）等应用领域。并对技术展开介绍，包括技术名称、技术应用领域、技术能力水平，以及每项技术的成熟度（1-3级（实验室原型），4-6级（中试验证），7-9级（量产应用））。 | | | | |
| **晶上技术能力提升计划** | 十五五期间，晶上技术能力提升规划及目标。  例：2026年，规划开发XXX技术，技术指标达到XXX水平，技术成熟度达到XXX阶段（实验室、中试、量产）。  **该部分内容仅录入十五五晶上产业技术能力战略资源库，用于院士团队评估项目能力水平和开展晶上项目策划，不做公开宣传。** | | | | |
| **宣传需求** | **□ 仅入库，所有内容均不公开展示**  **□ 部分内容可在晶上产业图谱公开展示**  □ 仅展示公司名称  □ 可部分展示当前项目能力水平（不能公开展示的内容，请以下划线的形式进行标注）  **□ 绿色版块内容全部可公开展示**  **□ 需定制化宣传（如嵌入企业超链接、二维码、技术文档等，联盟秘书处将定向展开具体沟通对接）** | | | | |
| **联络人** |  | | **职务** | |  |
| **联系电话** |  | | **邮箱** | |  |

请各单位完成表格填写，并于5月10日前反馈至晶上联盟秘书处。

联系人：王亚会 / 季俊娜

电话：15998673932 / 15002298817

邮箱：wangyahui@sdsow.org.cn